

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-037

有研半导体硅材料股份公司 关于调整公司2024年股票期权激励计划 行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将具体调整事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的审批程序

1. 2024年9月10日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

同日,公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于调整公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。监事会对本次激励计划的有关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

2. 2024年9月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-040),独立董事袁少卿受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3. 公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次激励计划的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-042)。

4. 2024年9月27日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本次激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日。在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权必需的全部事宜。

5. 2024年9月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-043)。

6. 2024年10月10日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就,同意以2024年10月10日为授予日,向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。2024年10月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2024-047)及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单(截止授予日)》。

7. 2024年10月24日,公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划首次授予未登记登记的公告》(公告编号:2024-048)。公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8. 2025年3月14日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本次激励计划授予预留部分期权条件已经成就,同意以2025年3月14日为授予日,以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

9. 公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共10天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年03月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10. 2025年4月23日,公司披露了《有研硅关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》。股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日,股票期权预留授予登记数量为90.00万份,股票期权预留授予登记人数为34人。

11. 2025年10月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据2024年第二次临时股东大会的授权,对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整,行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。同时,第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。鉴于本次激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核未达到触发值但未达到目标值,公司层面可行权比例为80%,部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权,公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份,公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权,本次实际可行权激励对象为92名,行权数量为268.08万份,行权价格为9.05元/股。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。12. 本次股票期权激励计划行权价格的调整说明

(一)调整原因

2025年4月25日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年利润分配方案的议案》,同意向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,247,621,636股,扣除回购股份3,555,336股,以此计算本次拟派发现金股利7,643,943.32元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.05%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-010)。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》的规定,在本次激励计划实施公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,若公司发生派发股票红利的情况,股票期权的行权价格和权益数量将根据本次激励计划做相应的调整。

(二)调整情况

根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》的规定,本激励计划公告日至调整完成股票期权股份登记期间,公司将派发股票红利的情况,应对股票期权行权价格进行相应的调整,但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下:

P=P₀

其中:P₀为调整前的行权价格;P₁为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。根据以上公式,本次调整后的行权价格为9.11-0.06=9.05元/股。公司董事会根据2024年第二次临时股东大会授权对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整,经过本次调整后,行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。

三、本次股权激励对公司影响

公司股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,也不会影响公司股票期权激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬和考核委员会意见

公司董事会薪酬和考核委员会认为:本次调整符合《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》中关于股票期权行权价格调整的相关规定,调整程序合法、合规,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。同意对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整。特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-034

有研半导体硅材料股份公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料于2025年10月20日通过电子邮件方式送达全体董事。出席会议的董事9人,出席列席董事9人。会议由董事长方永义先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整部分投资项目实施方案暨部分投资项目延期及新增投资项目的议案》。公司将“集成电路制造设备用硅材料项目”中一部分资金11,922万元用于新建“集成电路用8英寸硅片再扩”项目,“集成电路制造设备用硅材料项目”现已可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月,新建项目预计完成时间为2026年12月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于调整部分投资项目实施方案暨部分投资项目延期及新增投资项目的公告》。

该议案尚需提请公司董事会审议批准。

(二)审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》。为了更好地发挥股权激励作用,确保公司长期发展目标的实现,公司结合相关法律法规的规定和实际情况,进一步明确了2024年股票期权激励计划预留部分企业绩效考核要求和个人层面绩效考核要求。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次审议审议通过。

(三)审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》相关规定,鉴于在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司发生派发股票红利的情况,股票期权的行权价格将根据本次激励计划相应调整。经本次调整后,行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次审议审议通过。

(四)审议通过《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》。根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》相关规定,公司2024年息税前利润(EBITDA)为4.11亿元,达到触发值但未达到目标值。公司层面可行权比例为80%。根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定,公司对股票期权激励计划首次授予的92名激励对象进行了2024年度考核。其中,82名激励对象的年度考核考核结果为“A”,10名激励对象的年度考核考核结果为“B”。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次审议审议通过。

(五)审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,2024年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次审议审议通过。

(六)审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》相关规定,本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核未达到触发值但未达到目标值,公司层面可行权比例为80%,部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权,公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份,公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次审议审议通过。

(七)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定,公司编制了2025年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司2025年第三季度报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次审议审议通过。

(八)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司使用部分闲置募集资金(含募集资金)不超过人民币50,000万元(含本数)进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-036

有研半导体硅材料股份公司 关于2024年股票期权激励计划预留部分 考核的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年10月27日,有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》。根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)或“本次激励计划”的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会授权,董事会关于公司2024年股票期权激励计划的预留部分考核进行了明确,现将有关事项说明如下:

一、本次股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年9月10日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。2024年9月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-042)。

同日,公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于调整公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。监事会对本次激励计划的有关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

2. 2024年9月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-040),独立董事袁少卿受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3. 公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次激励计划的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-042)。

4. 2024年9月27日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本次激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日。在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权必需的全部事宜。

5. 2024年9月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-043)。

6. 2024年10月10日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就,同意以2024年10月10日为授予日,向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。2024年10月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2024-047)及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单(截止授予日)》。

7. 2024年10月24日,公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予未登记登记的公告》(公告编号:2024-048)。公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8. 2025年3月14日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本次激励计划授予预留部分期权条件已经成就,同意以2025年3月14日为授予日,以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

9. 公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共10天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年03月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10. 2025年4月23日,公司披露了《有研硅关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》。股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日,股票期权预留授予登记数量为90.00万份,股票期权预留授予登记人数为34人。

11. 2025年10月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》,薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

二、预留授予部分考核情况说明

(一)公司层面业绩考核要求

为了更好地发挥股权激励作用,确保公司长期发展目标的实现,公司结合相关法律法规的规定和实际情况,进一步明确了2024年股票期权激励计划预留部分企业绩效考核要求和个人层面绩效考核要求。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的公告》。

本激励计划预留授予部分考核年度为2025-2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次。以公司2024年度(EBITDA)为基数,对考核年度的息税前利润和利润进行考核,根据上述指标的完成情况核算各年度公司层面的考核比例。

行权期	业绩考核年度	息税前利润和利润(EBITDA)(A)	触发值(A ₀)	触发值(A ₁)
预留授予部分第一个行权期	2025年	X<100%	4.52亿元	4.2亿元
预留授予部分第二个行权期	2026年	X<100%	4.82亿元	4.2亿元
预留授予部分第三个行权期	2027年	X<100%	5.02亿元	4.2亿元

预留授予部分的行权期,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期,公司当期业绩水平未达到下述业绩考核条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

考核指标	业绩考核年度	息税前利润和利润(EBITDA)(A)	触发值(A ₀)	触发值(A ₁)
2025年息税前利润和利润(EBITDA)(A)	2025年	X<100%	4.52亿元	4.2亿元
2026年息税前利润和利润(EBITDA)(A)	2026年	X<100%	4.82亿元	4.2亿元
2027年息税前利润和利润(EBITDA)(A)	2027年	X<100%	5.02亿元	4.2亿元

注1:上述“息税前利润和利润(EBITDA)”以经审计的合并财务报表所载数据为计算依据,且剔除本次激励计划实施期间其它后续激励计划行权的支付费用影响的数据;

注2:本激励计划触发值的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

(二)个人层面绩效考核要求

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其行权额度。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次。届时根据以下考核等级表中所对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际行权额度:

考核等级	A	B	C	D
行权比例	100%	80%	0%	0%

激励对象个人当期可行权数量=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例(X)×个人层面行权比例(Y)。

激励对象当期因考核原因不得行权的股票期权,作废失效,不可递延至以后年度,由公司统一安排注销。

三、薪酬和考核委员会的意见

薪酬和考核委员会认为:本次公司进一步明确了预留部分股票期权行权的考核指标,有利于保障本次激励计划的顺利实施,能够有效激励和约束公司利益相关者和核心团队人员目标结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,提升公司的市场竞争力与可持续发展能力,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-038

有研半导体硅材料股份公司 关于2024年股票期权激励计划首次授予 第一个行权期行权条件成就暨注销部分 股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股票期权行权数量:268.08万份

●行权股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》,根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,现有有关事项说明如下:

一、股票期权激励计划批准及实施情况

(一)股票期权激励计划方案及履行程序

1. 2024年9月10日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

同日,公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,监事会对本次激励计划的有关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

2. 2024年9月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-040),独立董事袁少卿受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3. 公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次激励计划的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-042)。

4. 2024年9月27日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本次激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日。在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权必需的全部事宜。

5. 2024年9月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-043)。

6. 2024年10月10日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就,同意以2024年10月10日为授予日,向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。2024年10月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2024-047)及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单(截止授予日)》。

7. 2024年10月24日,公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予未登记登记的公告》(公告编号:2024-048)。公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8. 2025年3月14日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本次激励计划授予预留部分期权条件已经成就,同意以2025年3月14日为授予日,以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对预留授予